

JPCA2024
Show

第53回国際電子回路産業展



マイクロエレクトロニクスショー

第38回 最先端実装技術・パッケージング展



JISSO
PROTEC 2024

第25回 実装プロセステクノロジー展



～装置と装置をつなぐ～

WIRE Japan Show
2024

電気・光伝送技術展

Electronics
Component & Unit
Show

JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合



E-Textile/Wearable

イーテキスタイル/ウェアラブル展

Smart Sensing

スマートセンシング



無人化ソリューション展



Edge Computing

エッジコンピューティング



出展の
ご案内

電子機器2024 トータルソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment 2024

2024. 6. 12 Wed. → 14 Fri.

東京ビッグサイト 東展示棟 | Tokyo Big Sight, East Exhibition Halls

出展申込受付開始：2023年11月1日（水）10:00～



展示会公式サイトへ

主催：一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会
共催：電子デバイス産業新聞 [(株)産業タイムズ社]、電線新聞 [(株)工業通信]、
(株)JTBコミュニケーションデザイン、
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合、株式会社社織研新聞社、
後援(予定)：経済産業省

海外協力：世界電子回路業界団体協議会 (WECC) 加盟団体
中国電子回路行业协会 (CPCA)、欧州電子回路協会 (EIPC)、インド電子工業会 (ELCINA)、
香港線路板協会 (HKPCA)、米国電子回路協会 (IPC)、インド電子回路工業会 (IPCA)、
韓国電子回路産業協会 (KPCA)、タイ電子回路工業会 (THPCA)、
台湾線路板協会 (TPCA)

Association of Electronic Industries in Singapore (AEIS)
Korea Packaging Integration Association (KPIA)

2023/10/20版

エレクトロニクスの機能を具現化する 全てがココにある!!

最先端の電子回路基板、実装、装置、プロセス、そして電子部品を誇る500社(予定)が集い、世界最高峰の技術に触れる機会をご提供致します。

開催概要

| | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------------------------|
| 会期 | 2024年6月12日(水)~14日(金) 午前10時~午後5時 | | |
| 会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 | 本部事務局 | 一般社団法人 日本電子回路工業会(JPCA) |
| 入場料 | 1,000円(税込) ※WEB登録で無料 | 運営事務局 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |


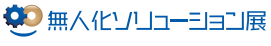

最先端のアプリケーションに関する企画を多数開催

電子回路基板、実装、関連装置、材料/プロセス、自動運転向け高速伝送技術、EV向け大電流技術、アドバンスドパッケージング技術、パワー半導体・ガラス基板向け材料/プロセス技術、気候変動対策に寄与する低エミッション技術、E-Textile/Wearable技術、センサー&センシング技術、無人化技術/ソリューション、Edge Computing/オンデバイス技術、等

構成展示会・出展対象

| 電子回路技術 | 高密度実装技術 | 電子部品実装技術 |
|---|--|--|
|  <p>第53回国際電子回路産業展</p> <ul style="list-style-type: none">●プリント配線板技術展 電子回路基板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵基板・部品内蔵に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する製品・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、基板材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等)●機器・半導体受託生産システム展 EMS・ODM及び半導体の受託生産に関するサービス・技術全般(設計・シミュレーション、信頼性・検査、材料、機能・プロセス材料、製造装置、関連システム、等) 主催：一般社団法人日本電子回路工業会 |  <p>マイクロエレクトロニクスショー</p> <p>第38回 最先端実装技術・パッケージング展</p> <p>実装・電子技術に関する技術全般(材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージング/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等)</p> 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 |  <p>第25回 実装プロセステクノロジー展</p> <ul style="list-style-type: none">■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機(マウンタ)、電子部品挿入機(インサータ)、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置(リフローオーブン)、ディスプレイ■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン・材料、バルクフィーダ、その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置・洗浄剤■半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR■検査・試験装置：基板外観検査装置、半導体製造関連検査・測定装置■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材料■実装接合システム・はんだ/接合材料■高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料 主催：一般社団法人日本ロボット工業会 |

| メタバースデバイス | 電気・光伝送技術 | 半導体・電子部品 | 高機能テキスタイル |
|--|--|--|--|
|  <p>メタバースデバイス展</p> <p>メタバースに関する製品・技術全般(半導体(プロセス/センサー、メモリー、センサー)、AR/VR/MRゴーグル/ディスプレイ(マイクロLED、有機EL)/カメラ/ヘッドセット/コントローラー、冷却デバイス、等)</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞((株)産業タイムズ社) |  <p>WIRE Japan Show 2024</p> <p>電気・光伝送技術展</p> <p>ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般(産業用機器/電線、ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線、ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間(M2M)伝送/光伝送等)</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞((株)工業通信) |  <p>Electronics Component & Unit Show</p> <p>JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合</p> <p>半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般(半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等)</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 |  <p>E-Textile/Wearable</p> <p>イーテキスタイル/ウェアラブル展</p> <p>電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル(スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術)に関する技術全般(繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等)</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社織研新聞社 |

| センサー技術 | 無人化技術・ソリューション | エッジソリューション・オンデバイス技術 |
|--|--|---|
|  <p>スマートセンシング</p> <p>センサー及びセンシングシステムに関する技術全般(センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス)</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |  <p>無人化ソリューション展</p> <p>労働力不足を解消し製造工程の無人化、省人化を支える無人化技術、ソリューション、または無人化のための省力化・遠隔化・自動化・非接触化の技術・ソリューション全般 監視システム/遠隔操作システム/先進運転支援システム/ディーラーニング/非接触・タッチレス/無人営業サービス/AR/異常検知/顔認証/AI等</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |  <p>Edge Computing</p> <p>エッジコンピューティング</p> <p>オンデバイス技術、低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般 ボードコンピュータ/シングルボードコンピュータ/エッジデバイス/OS/エッジAI/アプリケーション/画像分析/エッジセキュリティ/各種システム等</p> 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |

NEW アプリケーションゾーンの設置 (ゾーンへの出展をご希望の場合は、出展申込時にゾーンを選択してください。)

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 自動運転 自動運転向け高速伝送技術ゾーン | EV EV向け大電流技術ゾーン | パワー半導体/ガラス基板 パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術ゾーン |
| アドバンスドパッケージ チップレット等の最先端半導体パッケージング技術ゾーン | 気候変動対策 気候変動対策に寄与する低エミッション技術ゾーン | |

2023年開催実績

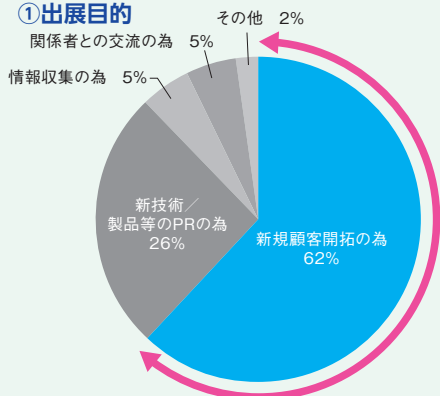
会場 **東京ビッグサイト 東展示棟**

出展規模 **517社 / 1,273小間** 来場者数 **48,018名**

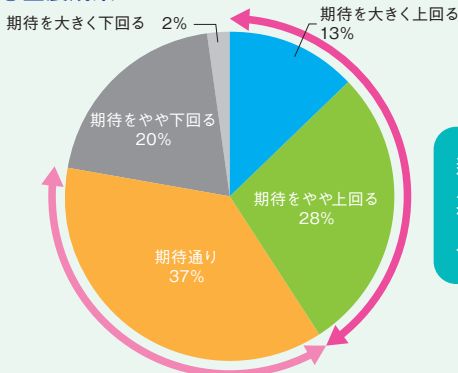
2023年展実績

● 出展者アンケート

① 出展目的

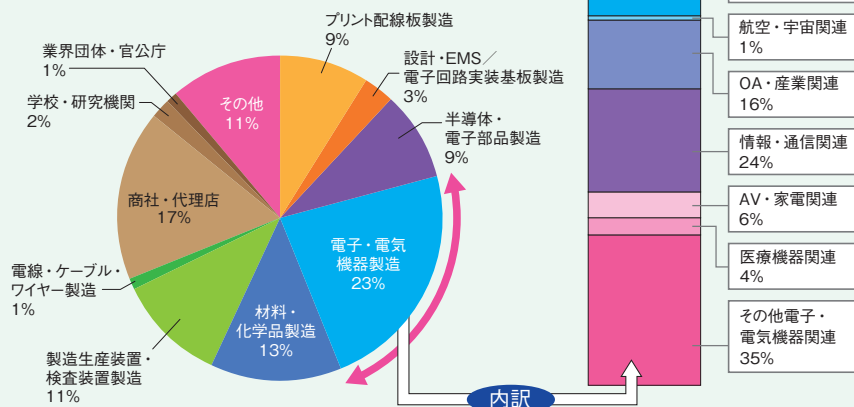


② 出展成果



新規顧客開拓を目的に出展し、41%の出展者は期待を上回る成果を、78%の出展者は期待通り以上の成果をあげる。

● 来場者業種分類



従来の電子・電気機器製造来場者にとどまらず、新しいアプリケーション分野の来場者層とのネットワークが期待できる。

注目 新しいネットワーク形成の場を提供

「出展者交流会」を開催し、出展者間のネットワーキングを促進します！

「学生ウェルカムブース」「交流プラザ」を設置し、エレクトロニクスの明日を担う若い世代を歓迎します！

来場実績

◆ 多種多様な業種・業界よりご来場！

半導体、通信、モビリティ(自動車、二輪車、自転車)、船舶、電車、航空機、農業、交通インフラ、ロジスティクス、ゲーム・玩具、メタバース、AI、AR/VR、各種システム・ソリューションプロバイダー、林業、水産業、食品、教育、医療/ヘルスケア、運輸、アパレル/スポーツ用品、金融、地方自治体、美容、スマート家電、防衛装備、e-Sports、AV、ドローン、ウェアラブル機器、センサー、防災、ロボット、バイオメトリクス、エネルギー、Dx/Gx/Cx/Sx、観光Dx、サイネージ、スマートx、等

AGC、AmkorTechnology、CKD、DIC、HUAWEI、JAグループ、JFEグループ、JR東日本グループ、JSR、JTB、JVCケンウッド、KDDIグループ、LGグループ、LIXIL、NECグループ、NHKテクノロジーズ、NTN、NTTグループ、Rapidus、SKグループ、SMBCグループ、SUBARU、SUMCO、TDK、THK、TOTO、TSMCグループ、YKK、アイシングループ、アサヒ飲料、イオングループ、インテル、オカムラ、オムロングループ、オリンパス、カシオ計算機、カナダ国立研究機構、関西電力グループ、キャノン、きんでん、クボタ、シチズン時計グループ、シャープ、シャチハタ、セイコーウオッチ、日本ゼオン、セコム、ソニーグループ、ソフトバンク、タイガー魔法瓶、ダスキン、テルモ、テレビ埼玉、テレビ東京、デロイトトーマツコンサルティング、デンソーグループ、トーエネック、トヨタ自動車、トヨタ車体、ニコン、ニプログループ、ノリタケカンパニーリミテド、パーク24、長谷工グループ、パナソニックグループ、ヒロセ電機、フォスター電機、ブラザー工業、プリジストングループ、ホシデン、ミサワホームグループ、みずほグループ、ヤマハ、リコー、りそなグループ、リンナイ、レゾナック、レノボジャパン、ロームグループ、愛三工業、愛知製鋼、旭化成、安川リニューアブル、伊藤忠商事、宇宙航空研究開発機構、横河電機、横浜銀行、横浜国立大学、加賀電子、華為技術日本、丸紅、岩谷産業、京セラ、九州大学、九州電力、慶應義塾大学、兼松、古河電気工業、戸田建設、黒田電気、三井化学、三菱UFJ銀行、三菱自動車工業、三菱商事、三菱総合研究所、三菱電機、三和シャッター工業、産業技術総合研究所、資生堂、鹿児島県、住友商事、住友電装、出光興産、商工組合中央金庫、小糸製作所、小森コーポレーション、森永乳業、清水建設、川崎重工業、倉敷紡績、早稲田大学、総合警備保障、村田製作所、太陽誘電、大阪産業技術研究所、大阪大学、大日本印刷、大林組、大和ハウス工業、帝人、島津製作所、東レ、東海理化、東京エレクトロン、東京ガス、東京消防庁、東京大学、東京地下鉄、東芝グループ、東北大学、東洋紡、南亜グループ、日亜化学工業、日産自動車、日東紡、日本IBM、日本サムスン、日本テキサス・インスツルメンツ、日本ハネウェル、日本経済新聞社、日本東洋、日本無線、日立造船、農業食品産業技術総合研究機構、富士キメラ総研、富士ソフト、富士フィルムグループ、富士通グループ、豊田合成、豊田自動織機、本田技研工業、明電舎、野村総合研究所、野村證券、矢崎総業、矢野経済研究所、等 (順不同・敬称略)

● 海外来場者：27か国・地域から来場

■ 出展料金

| 区分 | | 1小間 / 9m ² |
|--------|--------|-----------------------|
| 一般 | | 496,100円(税込) |
| 会員企業*1 | 通常 | 423,500円(税込) |
| | 早期 | 396,880円(税込) |
| | 20小間以上 | 372,075円(税込) |

*1 対象：JPCA会員 / JIEP正会員・賛助会員 / JARA正会員・賛助法人会員 / JEP・TEP正会員
※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。
※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

■ 出展申込 (2023年11月1日 (水) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)
出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。
貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。
専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。
出展申込書を受領後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

■ 申込締切

| | |
|------------------|---------------|
| 早期申込締切日(対象:会員企業) | 2024年1月31日(水) |
| 最終申込締切 | 2024年2月29日(木) |

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。
※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

■ 取消料

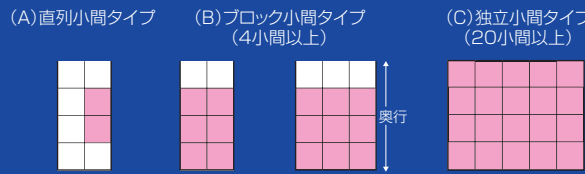
出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

| 書面による取消通知を受理した日 | 取消料 |
|------------------|-----------|
| ～2月29日(木) | 小間料金の 30% |
| 3月1日(金)～3月31日(日) | 小間料金の 50% |
| 4月1日(月)～4月30日(火) | 小間料金の 70% |
| 5月1日(水)～ | 小間料金の100% |

■ 開催までのスケジュール

| 2023年11月 | 2024年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|----------------------------------|--|---------------------------|---|------------------------------|----|---|
| ▲ 11月1日(水) 10:00～ 出展申込受付開始 | ▲ 1月31日(水) 出展早期申込締切 (対象:会員企業) | ▲ 2月29日(木) 出展最終申込締切 | ▲ 3月中旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開 ▲ 3月下旬 小間位置選択会開催 | ▲ 4月中旬 招待状発送 来場登録開始 | | ▲ 6月10日(月)～11日(火) 搬入期間 ▲ 6月12日(水)～14日(金) 展示会開催 ※最終日即日撤去 |
| ← 3月中旬～随時 各種提出書類期限 → | | | | | | |

■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

■ 小間位置の決定

小間位置選択会(2024年3月下旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。

原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。

※詳細は出展規約をご確認ください。

■ 出展者サポートプログラム 有料・オプション

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

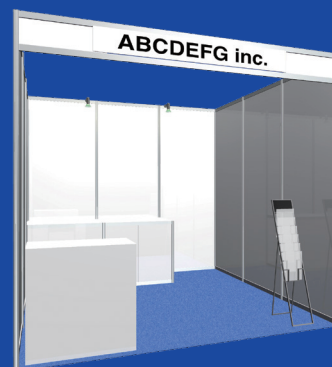
※詳細は別途出展者説明会(2024年3月中旬開催予定)でご案内します。

■ パッケージブースプランのご案内 有料・オプション

● 1小間ベーシックプラン

価格(予定)：¥118,800(税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。詳細は出展者説明会(2024年3月中旬開催予定)にて配布する資料をご確認ください。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ

電子機器トータルソリューション展2024 出展申込書

申込締切日

早割 2024年1月31日(水)
会員企業のみ
最終 2024年2月29日(木)

※必ず控えのコピーを取り、保管して下さい。

送付先 運営事務局 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン 〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階 TEL. 03-5657-0767 メール: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局: (一社) 日本電子回路工業会 行

※招待状など全ての基本データとなりますので正確にご記入下さい。
※特に会社/団体名はフリガナ、英文名も忘れずにお願ひします。

こちらのURLからオンライン出展申込が可能です。ぜひご利用下さい。

オンライン申込: <https://application.jcdebizmatch.jp/jp/JPCA2024/JPCA>

主催者が定める出展規約・個人情報取扱い(裏面参照)に同意し、下記の通り出展を申し込みます (☑◎必須) 申込日 年 月 日

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|----|---|--|---|
| 会社/団体名 *法人格含む | 和文 | フリガナ | | | | 印 |
| | 英文 | | | | | |
| 申込責任者 | 部署 | 役職 | 氏名 | 印 | | |
| 連絡先 | 所在地 | 〒 | | | | |
| | 部署 | 役職 | 氏名 | | | |
| | TEL | FAX | | | | |
| | Email | | | | | |

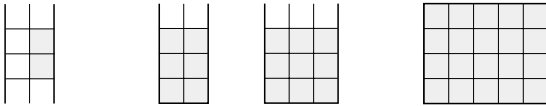
共同出展(同一小間内出展) ※複数企業ご登録の場合はコピーしてご利用下さい。また、共同出展者へのご連絡を希望の場合は、別途運営事務局までご連絡先をお知らせ下さい。

| | | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|-----|
| 会社/団体名 *法人格含む | 和文 | フリガナ | | | | 企業名 |
| | 英文 | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 他出展企業とタイアップ出展(隣接)を希望します。 ※タイアップ出展: 出展申込をする2社・団体が、ブースの隣接/近接を希望する場合に使用します。 ※共同出展: 出展申込みをする1社・団体が、自ブース内で複数社で共同出展する場合に申請します。 申請は出展者説明会で配布される出展マニュアルをご参照ください。 | | | | | | |

■出展料・申込小間数・小間形態

| 一般 | | 496,100円(税込) × | 小間 = | 円 |
|---|--------|----------------------------------|---|--|
| 会員企業 <input type="checkbox"/> JPCA会員 <input type="checkbox"/> JIEP賛助会員 <input type="checkbox"/> JARA正会員・賛助法人会員 <input type="checkbox"/> JEP・TEP正会員 | 通常 | 423,500円(税込) × | 小間 = | 円 |
| | 早期 | 396,880円(税込) × | 小間 = | 円 |
| | 20小間以上 | 372,075円(税込) × | 小間 = | 円 |
| 希望小間タイプ(下図参照) | | <input type="checkbox"/> (A)直列小間 | <input type="checkbox"/> (B)ブロック小間(4小間以上) | <input type="checkbox"/> (C)独立小間(20小間以上) |

(A)直列小間タイプ (B)ブロック小間タイプ(4小間以上) (C)独立小間タイプ(20小間以上)



※小間タイプはご希望に添いかねる場合がありますので、予めご了承下さい。

| | |
|-------|---|
| 出展料小計 | 円 |
| 内消費税 | 円 |
| 出展料合計 | 円 |

■出展希望構成展示会・製品 (※1点のみ)

小間位置選択会を行うため、該当項目に必ずチェックを入れてください。

JPCA Show

- プリント配線板技術展
 半導体パッケージング・部品内蔵技術展
 フレキシブルプリント配線板製品出展エリア
 機器・半導体受託生産システム展

- マイクロエレクトロニクスショー
 JISSO PROTEC
 メタバースデバイス展
 WIRE Japan Show

- [ゾーン] 自動運転向け高速伝送技術
 [ゾーン] EV向け大電流技術
 [ゾーン] パワー半導体/ガラス基板向け材料・プロセス技術
 [ゾーン] アドバンスドパッケージング技術
 [ゾーン] 気候変動対策: 低エミッション技術

プリント配線板技術展に✓をされた方は、下記出展製品・技術分野もご選択下さい。(※1点のみ)

●出展製品・技術分野

1. 製品(電子回路基板等の電子機器)
 2. 設計技術
 3. 信頼性・検査技術
 4. 主材料・絶縁材料
 5. 機能材料・プロセス材料・資機材
 6. 製造装置・設備
 7. 環境システム
 8. 物流システム
 9. その他

■出展予定製品及び・技術分野(フリー)

| |
|--|
| |
|--|

■通信欄

請求書等のご要望事項があればご記入下さい。

| |
|--|
| |
|--|

※以下の展示会にご出展希望の場合は、専用の申込用紙をご利用ください。

Electronics Component & Unit Show
E-Textile/Wearable

Smart Sensing
無人化/ローコスト展
Edge Computing

1. 契約の成立

主催者がオンライン出展申込システムにて、申込書を受理した時点で、本出展の契約が成立するものとします。主催者は申込書の受理を拒絶する権限を有します。なおこの場合、拒絶の理由は表明しないものとします。

(1) 2社以上の会社が共同で出展する場合

個別に出展申し込みをした2社以上が、隣接、近接するブース位置を希望する場合は、申し込み時に主催者へタイアップ出展の通知をするものとします。

また、2社以上の申込者が同一ブース内で共同で出展する場合、1社が代表して申し込み、共同出展する社名を主催者へ通知するものとします。

(2) 出展申込の拒否

破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令などの行政処分を受けた者の申込は受理いたしません。また、主催者が上記に等しいなどと認めた場合も同様とします。

なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展料については全額返却します。主催者は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。

(3) 電子媒体、FAXなどによる申込み

やむを得ず、オンライン出展申込システムによる出展申込ができない場合、電子媒体やFAX等による申込みを受付けます。その場合、運営事務局がオンライン出展申込システムへ代理で入力します。

2. 出展申込受付の基本条件

出展者は、JPCA Show / マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC / メタパースデバイス展 / WIRE Japan Show / Electronics Component & Unit Show / E-Textile/Wearableの開催主旨に合致し、出展案内に記載される各展示会の主な出展募集対象製品・技術分野に明示された内容以外の展示は原則できないものとします。

3. 出展料金支払い方法

出展者は運営事務局が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに出展料およびそれに付随するオプション代金を支払うものとします。出展者からの支払いは、運営事務局が請求書に記載した指定口座に日本円で支払うものとします。約束手形・小切手などの取扱いはいたしません。また振込手数料は出展者が負担するものとします。

4. 出展小間料に含まれるもの

- 出展小間スペース
- 出展者サービス全般
- その他展示会開催に関する費用など
- 仕切壁（隣接小間などがある場合、パネル）
- 安全管理に関する費用

5. 出展物の設置及び撤去

出展者は、主催者の定めるスケジュールに沿って小間内の装飾、及び出展物の搬入出を行わなければならないものとします。また、会期中の出展物の搬入・移動・搬出の必要が発生した場合は、主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。

6. 展示場の使用

宣伝・営業活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は、宣伝活動のために小間近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。装飾物などいかなるものも、割り当てられた面積の範囲を越えてはならないものとします。主催者はその音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物など、展示会の目的に沿わないすべての行為を禁止又は撤去する権限を有するものとします。上記の制限または撤去が行われた場合、主催者は出展者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

7. 出展物の管理と負傷

主催者は、展示会場の管理・保全について事故防止に最善の注意を払いますが、あらゆる原因から生ずる各出展物の損失または損害についてその責任を負いません。

8. 保証条項

(1) 出展者が本出展で出展スペース等に掲載した画像・動画・ロゴマーク・各種情報等のコンテンツは当該出展者に帰属します。尚、本展の広報活動のために、出展者から主催者へご提供いただいたコンテンツ等の情報につきましては、本展の公式ホームページ及び本展に関わる各種印刷物や広告・メルマガ・メディア媒体等への掲載を許諾いただいたものといたします。

(2) 出展者は主催者に対し、展示会の出品またはこれに関連する出品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するものとします。

9. 出展者の義務

(1) 出展者は主催者に対し、自己の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張があった場合、すみやかに自己の責任において第三者との紛議を解決し、展示会の正常かつ円滑な進行を妨げない義務を負うものとします。

(2) 団体出展の場合の責任者も、当該団体の構成員である出展者に対する第三者からの知的財産権侵害のクレームについて、前項と同様の義務を負うものとします。

10. 小間位置の決定

小間位置選択表（2024年3月下旬開催予定）にて小間位置を決定します。小間位置は、原則として同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、申込書を受理した順に選択順位を決定します。

11. 出展の取消及び小間数の削減について

出展申込者の都合により出展を取り消す場合または、小間数を削減する場合は、下記の通り取消料を申し受けます。

| 書面による取消通知を受理した日 | 取消料 |
|------------------|-----------|
| ～2月29日(木) | 小間料金の30% |
| 3月1日(金)～3月31日(日) | 小間料金の50% |
| 4月1日(月)～4月30日(火) | 小間料金の70% |
| 5月1日(水)～ | 小間料金の100% |

12. 小間の転貸・売買・譲渡・交換の禁止

出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展小間の一部あるいは全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。

13. 外国製品出展者および外国出展者への告知事項

(1) 主催者は保税展示場の申請を行いません。海外からの展示物の保税扱いを希望する場合には、出展者ご自身が保税手続きを行うものとします。

(2) 海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行うものとします。

(3) 主催者は、招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して発行いたしません。また、査証が発給されず、出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責を負いません。

14. 損害賠償

(1) 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備または展示会の建造物、もしくは人身などに対する一切の損失についての責任を負うものとします。

(2) 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務（弁護士報酬を含む）、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。

① 出展者の展示会の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合（出展者とともに被告とされた場合を含む）。

② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上もしくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合（和解について、主催者は出展者の意思に拘束されないものとする）。

(3) 主催者は展示会の告知広告、ガイドブックなどのプロモーション用資料の中に生じた誤字、脱字に関する責任を負わないものとします。

15. 展示会の中止・中断・変更

(1) 以下の場合により、主催者は展示会の開催及び継続が不可能若しくは困難であると判断した場合、展示会を中止、中断、会期の短縮および会期日程や会場の変更などを行う場合があります。

① 展示会場の土地建物が利用できなくなった場合、開催に不適切と主催者が判断した場合、など。

② 政府、行政、公的機関などによるイベントの自粛要請、自粛検討、自粛命令、中止要請、中止検討、中止命令などにより主催者が開催は適切でないとして判断した場合。

③ 不可抗力的事由により開催ができなくなった場合、開催が適切ではないと主催者が判断した場合、など。

(2) 前項の不可抗力的事由とは、台風、豪雨、暴風、水害、地震などを含む天災地変、疫病、公衆衛生リスク、交通機関の遅延・運休、戦争、内乱、テロ、ストライキその他、主催者の責めによらない事由を指します。

(3) 出展者はいかなる場合でも、その決定により被った損害を主催者に対して請求できないものとします。また主催者はいかなる場合でも、これによって生じる損害、費用の増加、その他出展者に生じた不利益的事態については責任を負わないものとします。

(4) 会期前、会期開始後に中止、中断と判断した場合、お申込みいただいた出展料はそれまでにかかった合理的な経費などを差し引きご返金いたします。

(5) (4)において、既に出展料をご入金されている場合は出展料からそれまでにかかった経費を引いた金額を返金いたします。未入金の場合は、出展料のご請求書は破棄いただき、別途それまでにかかった経費に関してご請求書を発行いたします。指定期日までにお振込みください。

(6) 上記にかかわらず、新型コロナウイルス(COVID-19)により中止した場合の出展費用は全額ご返金いたします。

16. 規約の遵守

出展者は、主催者が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

17. 規約の変更と追加

出展者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、主催者の決定に従うものとします。主催者は、開催ごとの出展者に通知の上、この規約を改訂あるいは追補できる権利を有するものとします。

18. 準拠法

本契約の準拠法は日本法とします。

19. 合意管轄裁判所

本契約に関する紛争の管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

【個人情報の取り扱いについて】

一般社団法人日本電子回路工業会は、「個人情報の保護に関する法律」並びに本工業会の「個人情報保護」(http://jpcas.jp/contactus/privacy/)に基づき、お客様の個人情報を以下にお取り扱いし、保護に努めます。お客様におかれましては、予めこれらをご了承の上、個人情報をご提供いただけますようお願いいたします。

- ・お預かりした個人情報は本展示会に関するご連絡のために使用します。
- ・お預かりした個人情報を第三者に開示することはございません。
- ・本展示会の円滑な運営のために、機密保持契約を締結した上で、個人情報の取扱いを(株)JTBコミュニケーションデザインに委託しています。
- ・ご本人からの、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用目的の通知、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のお求めにはすみやかに対応いたします。委託先の個人情報管理者までご連絡ください。
- (株)JTBコミュニケーションデザイン 事業共創部 トレードショー事業局長 長谷川裕久 連絡先: 03-5657-0623
- ・個人情報の提供は、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービスなどが適切な状態で提供できない場合があります。
- ・ご本人が容易に認識できない方法による取得を行うことはございません。

ご不明な点につきましては、下記までお問合せ下さい。

本部事務局：一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcas.org

運営事務局：株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp